

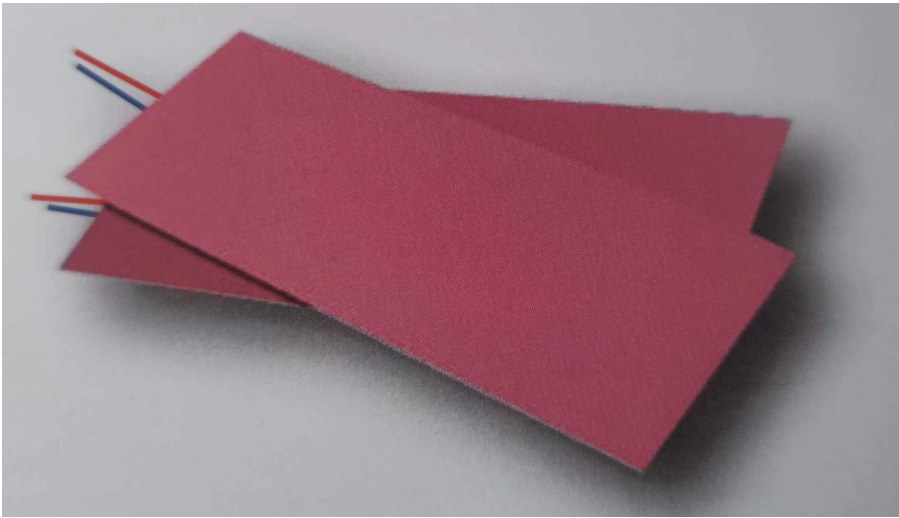
高温烧结系列导电银浆——石英加热管、陶瓷、云母加热片用

导电银浆 BY-0550PF

产品简介：BY-0550PF 导电银浆是上海宝银电子材料有限公司（BEMC）经过长期研制并开发的一种高性能烧结型无铅导电银浆。

典型应用：主要针对石英玻璃、镀膜玻璃基材做出的产品。

通用特点：有着良好的印刷性能、导电性能以及焊接性能。



技术指标：

物理性能指标	测试方法	测试标准
外观	肉眼观察	浅灰色胶体
气味		轻微
粘度（Pa.S）	NDJ-7 旋转式粘度计，Ⅱ转子，75rpm,25℃	35-45
细度（ μm ）	刮板细度计	<10
固含量（wt%）	烧失法，理论计算	$65\pm 2\%$
涂布面积（ cm^2/g ）	湿厚膜 $12\mu\text{m}$	15-20
烧结后性能指标	测试方法	测试标准
电阻（ Ω ）	线长 350mm、线宽 0.6mm，干膜厚 $6\pm 0.5\mu\text{m}$	$7\leq R\leq 12$
硬度（H）	使用一般刀具刀刮无成卷银片脱落	6
焊接强度（Kg）	标准圆形陶瓷片焊接，弹簧秤垂直慢慢拉引线，直至焊头与陶瓷片脱落	≥ 1
浆料方阻（ $\text{m}\Omega/\square$ ）	万用表	<6

使用说明及指引：

基 材：石英玻璃、镀膜玻璃。

搅 拌：使用前彻底搅拌均匀。搅释:本品搅拌均匀后即可使用，建议不加稀释剂。如需稀释，需使用专用稀释剂 X-BYJ 稀释，建议按小于银浆重量比例的 3%稀进行稀释，稀释后重新搅拌均匀。如添加稀释剂超过上述标准，产品质量和性能不予保证。

印 刷：本品适用于石英玻璃、镀膜玻璃印刷，固化后的膜厚和最终电阻受诸多相关因素影响，如网板的大小、张力、刮胶硬度印角度和速度、感光胶厚度等。

推荐固化工艺：

厚 度：湿膜 12 μm

丝 网：用 250 目聚酯丝网或不锈钢丝网

预 烘：IR 烘道 150℃ 5-10 分钟

烧 结：500-650℃ 5-10 分钟

储存条件及保质期：

密封保存于干燥、阴凉处，贮存温度在 5-25℃

未开封罐装，保质期为 6 个月。